

上海新康电子有限公司12寸晶圆分立半导体器件封装测试扩建项目

2022-10-14

建设单位	上海新康电子有限公司	联系人	谭谈
项目名称	上海新康电子有限公司12寸晶圆分立半导体器件封装测试扩建项目		
评价类型	职业病危害预评价		
项目地理位置:	上海市嘉定区永靖路1258号		
项目概况及评价范围:	本项目为上海新康电子有限公司在嘉定区永靖路1258号的扩建项目，在现有的A栋、B栋厂房2楼车间内新增工艺设备，用于半导体表面贴装器件的生产。该公司拟引入新一代晶圆检验机、绷膜机、打标贴片等设备，提升半导体集成电路分立器件的质量及技术等级，扩展产品的应用市场，在个人商用电子产品市场进入瓶颈期时，争取汽车电子市场的份额。		
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	高一鸣
审核人	陈荣	项目组成员	胡基业、曾秋霞
职业病危害因素	异丙醇、氮气、金属镍与难溶性镍化合物、钛、银、噪声、激光、紫外线		
评价结论及建议	本项目（用人单位）职业病危害风险属于严重。通过本项目各方面资料的综合分析，该项目总体布局、工艺设备布局、建筑卫生学、工程防护设施、个人防护用品、应急救援设施等方面基本符合《工业企业设计卫生标准》等法律法规和标准的相关要求。 如切实落实本报告中提出的相关建议，则用人单位工作场所可满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求		
专家组评审意见	专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为严重，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。		
报告完成时间	2022年10月14日		